

技术参数

5650

日期 : 08/2023

应用

特点

单组份环氧树脂胶粘剂，流动性好，固化速度快，具有优异的耐湿热可靠性性能；适用于CSP/BGA & SMT领域的底部填充；

粘接材料

金属，陶器，玻璃，木料

典型应用

CSP/BGA & SMT 底部填充

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂胶粘剂	
外观	半透明	
粘度	408cps	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	1min@150°C; 3mins@120°C	
比重	1.05 g/ml	ASTM D-1875

*固化温度是指固化时胶水本身达到的温度。

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	半透明	
邵氏硬度	76D	ASTM D-2240
玻璃化温度	75°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
工作温度范围	-55°C-150°C	

储运条件

使用方法

点胶，浸蘸，滚涂；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

储存方法

-20°C，冷冻保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 包装至少解冻2 小时，55ml 包装及以上大包装需要解冻更长时间至少解冻4 小时；

有效期

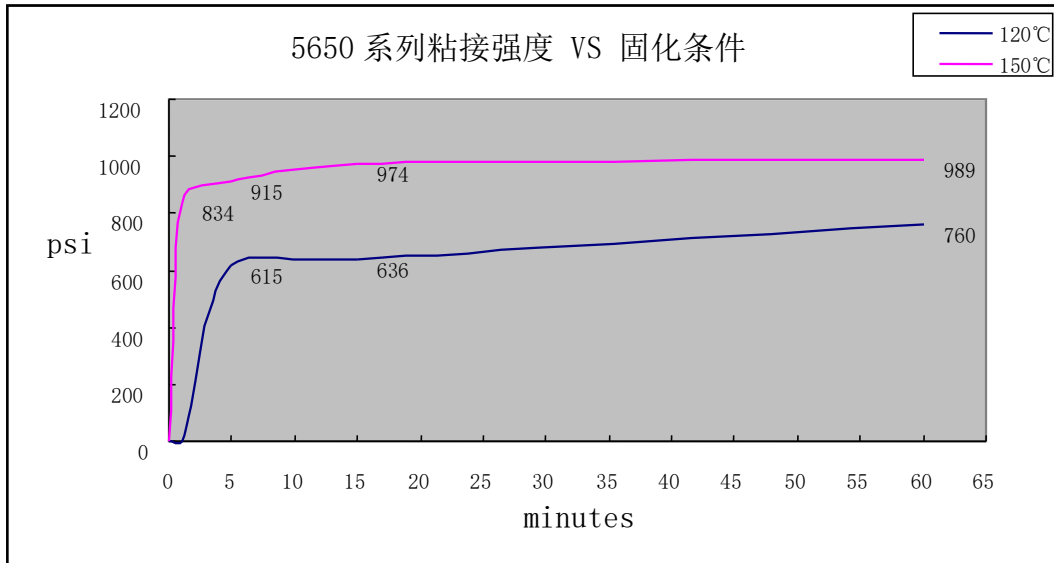
6 个月

包装

30ml 针筒装，55ml 针筒装，



其它信息



注:

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时, 我们对本产品的了解和经验而编写, 数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用, 差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围, 因此我们对产品的适用性不承担责任, 强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试, 并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本档内容可能会有更新, 除非有明确的书面承诺, 禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

